

A1

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



G00007

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
13. Februar 2003 (13.02.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

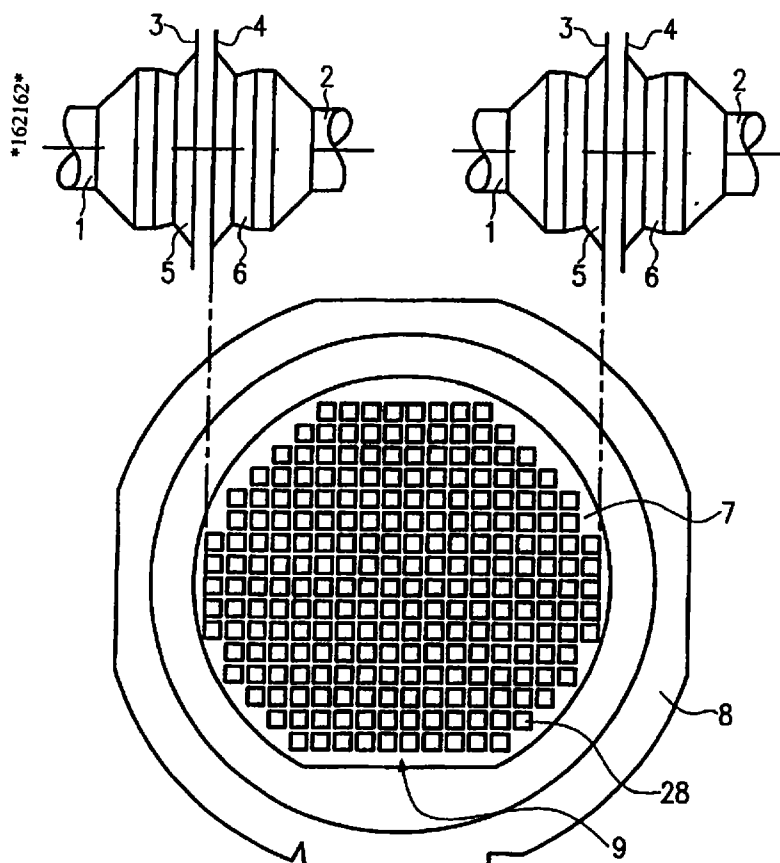
WO 03/011546 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: B28D 5/02, (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): DISCO HI-TEC EUROPE GMBH [DE/DE]; Liebigstr. 8, 85551 Kirchheim (DE)
B23D 61/02
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/08146 (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PRIEWASSER, Karl [DE/DE]; Disco Hi-Tec Europe GmbH, Liebigstr. 8, 85551 Kirchheim (DE).
- (22) Internationales Anmeldedatum: 20. Juli 2002 (20.07.2002)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch (74) Anwalt: WEBER, Joachim; Hofer, Schmitz, Weber & Partner, Gabriel-Max-Strasse 29, 81545 München (DE).
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 101 36 534.9 26. Juli 2001 (26.07.2001) DE (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MACHINE FOR CUTTING WAFERS

(54) Bezeichnung: WAFER-SCHNEIDEMASCHINE



(57) Abstract: The invention relates to a machine (1) for cutting wafers, comprising two rotatable work spindles (1, 2) which are coaxially arranged in relation to each other. Said spindles respectively carry, on the ends thereof, a cutting-off wheel (3, 4) positioned on a hub (5, 6), and can be displaced in relation to a working table (8) on which a wafer (7) can be mounted. The inventive machine is characterised in that the two cutting-off wheels (3, 4) are arranged in such a way that they are oriented in relation to each other, the hub (5, 6) being positioned on the rear side of the cutting-off wheel (3, 4) and arranged on the working spindle (1, 2).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine Wafer-Schneidemaschine (1) mit zwei koaxial zueinander angeordneten, drehbaren Arbeitsspindeln (1, 2), welche jeweils an ihrem Ende eine an einer Nabe (5, 6) gelagerte Trennscheibe (3, 4) tragen und relativ zu einem mit einem Wafer (7) bestückbaren Arbeitstisch (8) bewegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Trennscheiben (3, 4) zueinander weisend angeordnet sind, wobei die Nabe (5, 6) jeweils an der Rückseite der Trennscheibe (3, 4) positioniert und an der Arbeitsspindel (1, 2) angeordnet ist.

WO 03/011546 A1



GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist, Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen